

株式会社ジェイ・イー・ティ

2024年12月期  
決算説明会資料

2025年2月25日

1. 2024年12月期 決算概況・2025年12月期予想
2. 今後の成長戦略と進捗状況
3. サステナビリティ経営に向けて

## Appendix

# 1. 2024年12月期決算概況 2025年12月期予想

## 業績サマリー

洗浄装置立上案件が第1Qは少なく第2Qは回復、第3Qは中国ファウンドリ向け順調も韓国メモリーメーカーの投資が小休止、第4Qは韓国メモリーメーカー向け、中国ファウンドリ向けの立ち上げが延期 当連結会計期間の業績としては前年同期比減収減益に

<p><b>売上高</b> 17,880百万円</p> <p>前年同期比 ▲28.4%</p>	<p><b>営業利益</b> 789百万円</p> <p>前年同期比 ▲69.8%</p>	<p><b>経常利益</b> 662百万円</p> <p>前年同期比 ▲72.9%</p>	<p><b>純利益</b> 318百万円</p> <p>前年同期比 ▲80.7%</p>
---	---	---	--

- ✓ 米中貿易摩擦の激化、ウクライナ紛争の長期化、中東情勢の不安定化など地政学的な要因や米国大統領選の影響などもあり、経済環境は依然不透明。エレクトロニクス製品の消費停滞も継続
- ✓ 中国市場は、ここ数年間の中国での成熟世代半導体向け新規設備投資増強の反動から、ファウンドリにおいて設備稼働率停滞、投資減速
- ✓ メモリーもDRAMおよびNANDフラッシュの価格が下落、投資減速

## 連結業績

売上高減少のなか、計画していたコストダウン（材料費、外注費等）も想定通りには進まず、販管費の抑制に努めるも削減までは至らず

単位（百万円）	2023年12月期	売上比（%）	2024年12月期	売上比（%）	対前期比（%）
売上高	24,984	—	17,880	—	△28.4%
売上総利益	5,535	22.2%	3,711	20.8%	△32.9%
販管費	2,921	11.7%	2,922	16.3%	0.0%
営業利益	2,613	10.5%	789	4.4%	△69.8%
経常利益	2,444	9.8%	662	3.7%	△72.9%
当期純利益	1,651	6.6%	318	1.8%	△80.7%

# 連結貸借対照表

単位（百万円）	2023年12月期	2024年12月期	増減	主な増減要因
流動資産	27,068	23,824	△3,244	「現金及び預金」及び 「仕掛品」の減少
有形固定資産	954	831	△123	
無形固定資産	56	101	45	
投資その他資産	695	734	39	
資産合計	28,774	25,491	△3,283	
流動負債	11,496	8,570	△2,926	「前受金」の減少
固定負債	4,866	4,451	△415	長期借入金の減少
負債合計	16,362	13,021	△3,341	
純資産合計	12,411	12,469	58	
負債純資産合計	28,774	25,491	△3,283	

# 売上高・経常利益推移 売上構成

洗浄装置立上遅延などの影響で業績は踊り場に

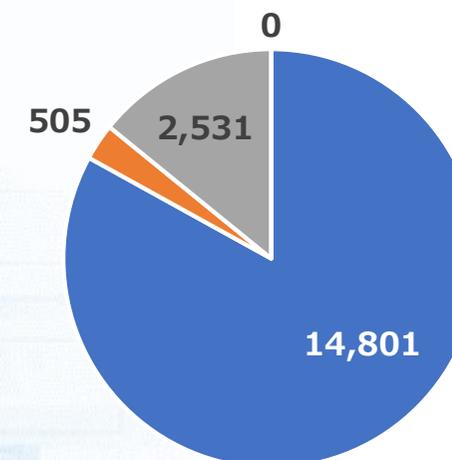
売上高・経常利益推移



セグメント別連結売上高



半導体事業内訳



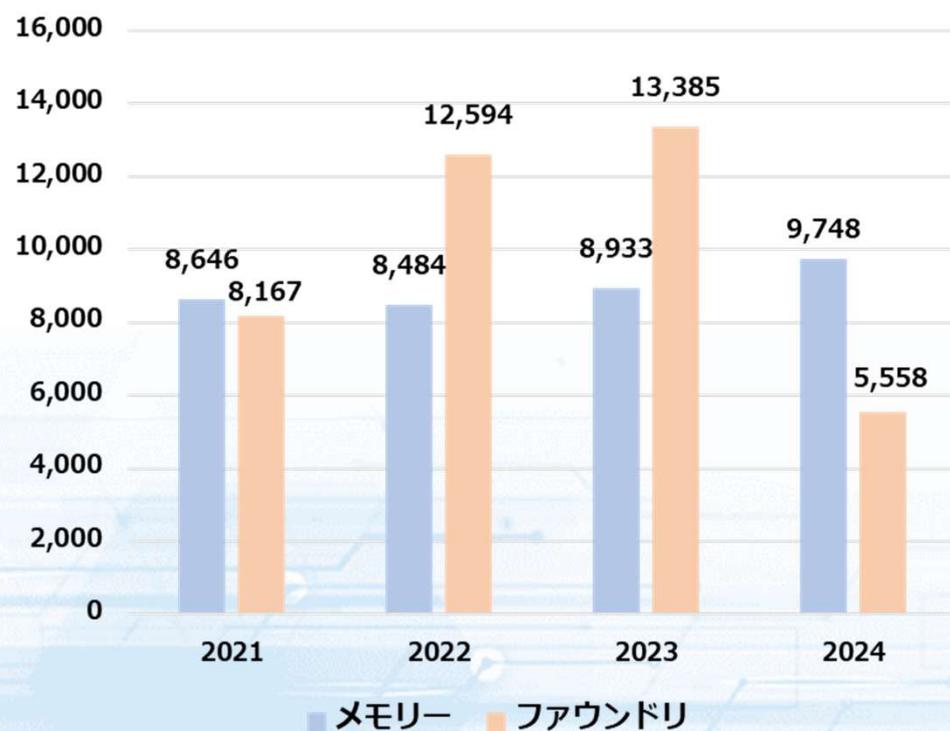
2024年12月期  
実績

■ バッチ式 ■ 枚葉式 ■ フィールドサービス ■ その他

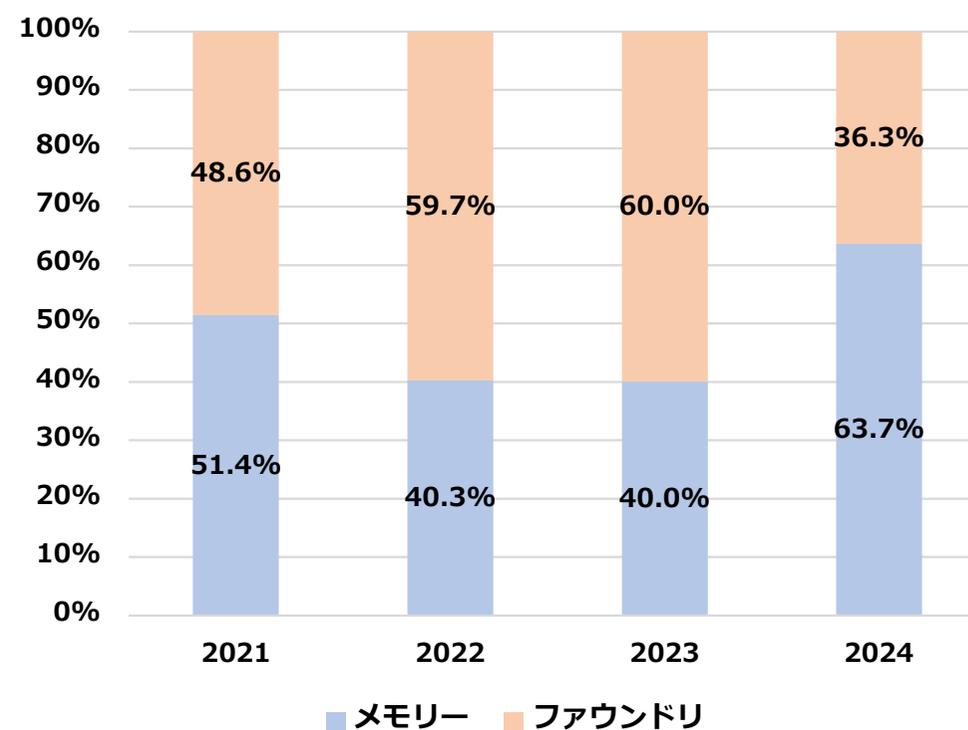
# 装置売上高推移（仕向け先別）

仕向け先別については、先述の通りファウンドリ向けが苦戦

## 仕向け先別装置売上高推移

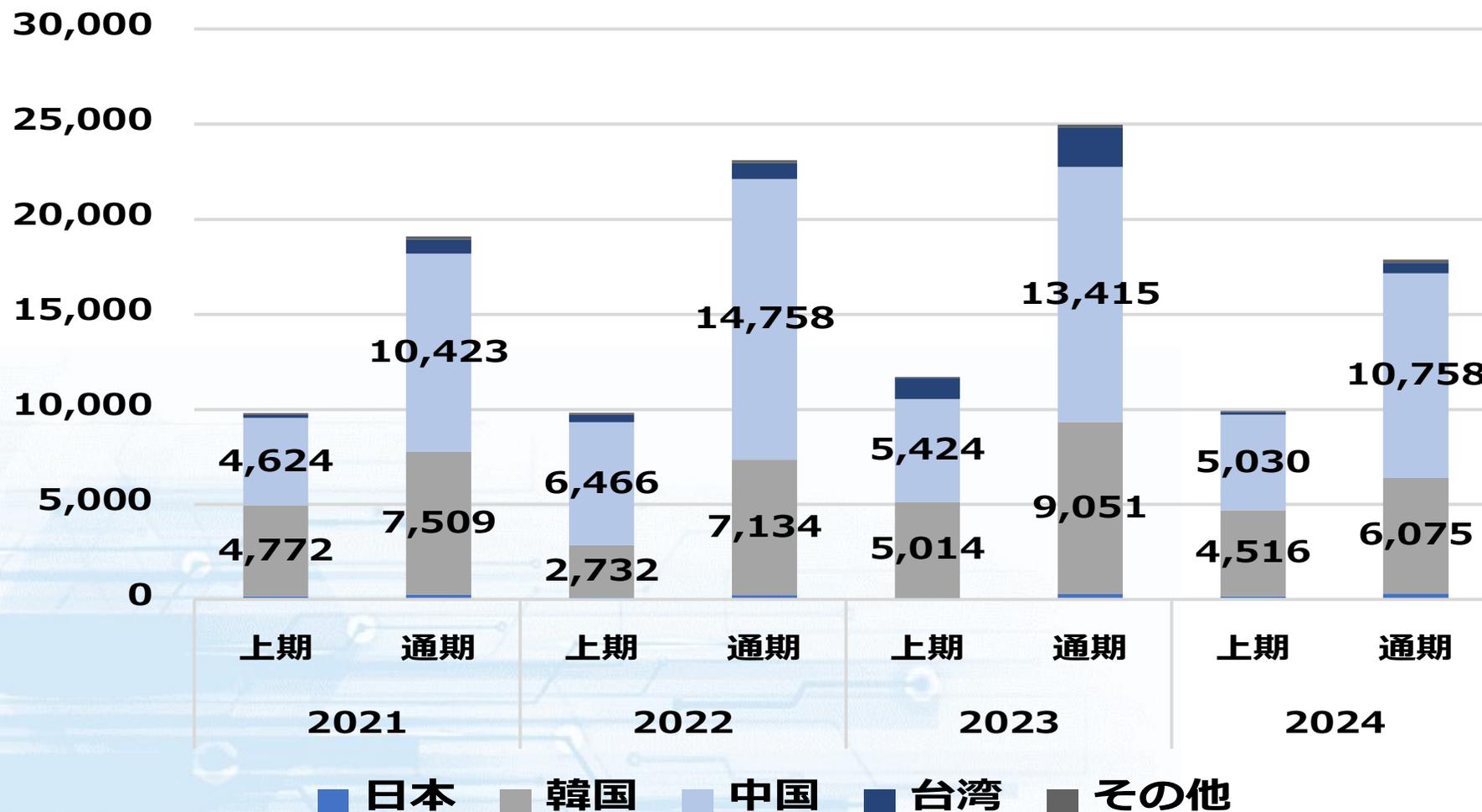


## 仕向け先別装置売上高構成比推移



# 地域別売上高推移

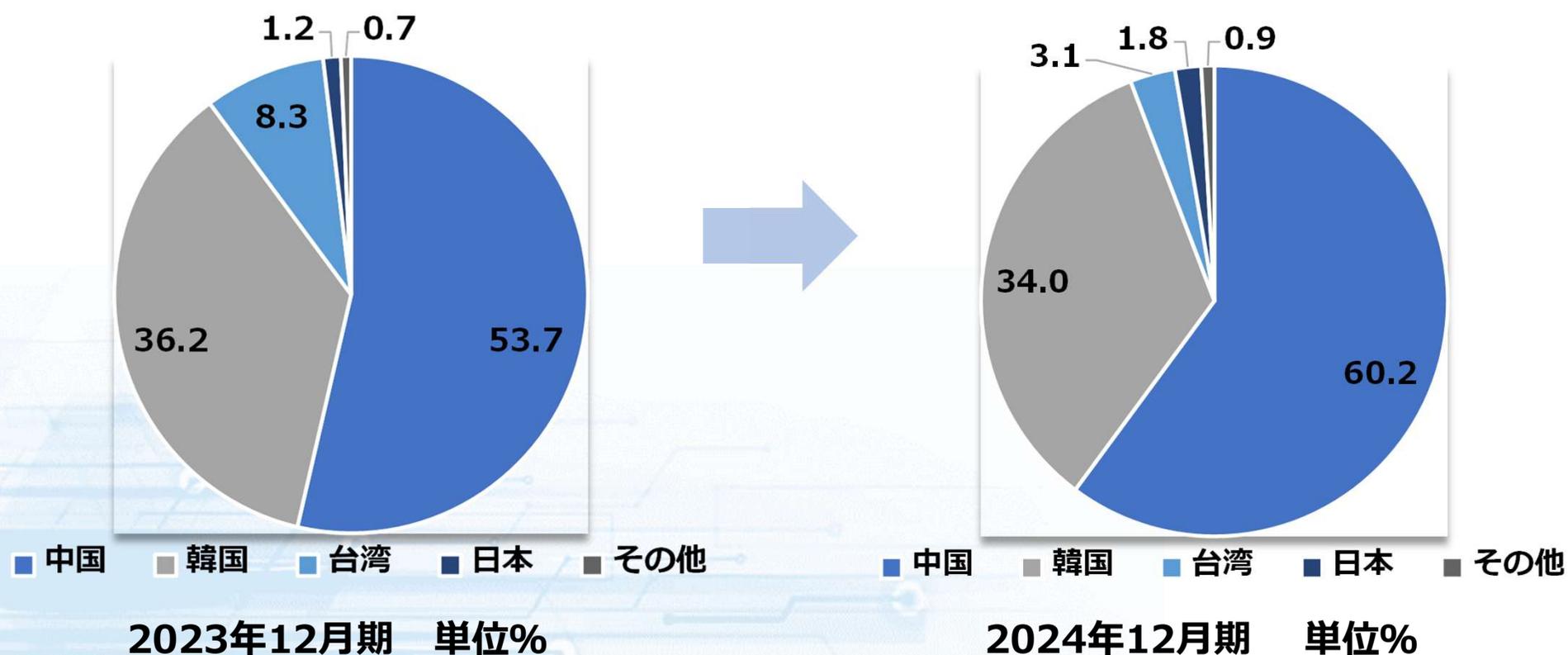
中国、韓国とも売上高は減少



# 地域別売上高構成比推移 前期比較

構成比的には中国の比率が上昇

\* 将来的には中国、台湾、韓国、米国・日本でそれぞれ25%の構成比を目指す



厳しい決算の中、次の成長に向け、幾つかの成果を実現

## 1. Rapidus 次世代半導体製造技術の研究開発受託

基礎研究開発業務（ $\alpha$ 機）を完了

試作装置製作に関する研究開発業務（ $\beta$ 機）に移行、2025年には装置納入  
2027年量産ラインへの当社装置納入を目指す

## 2. 「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」採択

\*「新本社工場建設による生産力拡大・生産性向上・研究開発の加速の実現」事業

本社のある里庄町に隣接する岡山県浅口市に約3万平米の用地取得を取締役会で  
決議。土地の引き渡しは2025年夏を予定 2024年12月13日リリース

## 3. 戦略機種 BW3500 販売開始

**300mmウェハ対応バッチ式洗浄装置**

**BW3000後継機種ながら自社製品の置き換え需要だけでなく、  
28nm以上の設備投資を意識し、他社製品からの切替、需要掘り起こし  
現地新興洗浄装置メーカーに対する技術優位の確立を企図  
中国・韓国にて受注および引き合い対応中**

## 4. サステナビリティ経営方針を公表

2024年12月13日リリース

## 引き続き、厳しい環境が続く

- ✓ 欧米の利上げやインフレは落ち着きつつあるものの、原材料やエネルギー価格の高騰、中国市場の景気減速は継続、地政学的な要因に加えトランプ新大統領の就任で環境は依然、不透明
- ✓ エレクトロニクス製品やEVの世界的な消費停滞の影響で、ファウンドリの稼働率は停滞、
- ✓ メモリーについても、一時持ち直したDRAM価格は下落、NANDフラッシュも厳しい

# 2025年12月期通期業績予想

厳しい環境ながら、以下の施策を通じ増収増益の達成を期す  
また、次の飛躍に向けた体制整備、装置開発に注力する

<b>売上高</b> 18,820百万円	<b>営業利益</b> 790百万円	<b>経常利益</b> 690百万円	<b>当期純利益</b> 370百万円
前期比 5.2%増	前期比 0.0%増	前期比 4.0%増	前期比 16.0%増

- ✓ DRAMの高容量化、NANDフラッシュの高層化などに対応し、市況に左右されず投資計画を実行する韓国メーカーに、新たな洗浄装置の提案を強化
- ✓ 米国子会社を通じた米国での新規顧客開拓強化
- ✓ 日本市場におけるセンサーおよび車載半導体向け等の顧客開拓強化
- ✓ 中国市場に対するBW3500拡販

## 2. 今後の成長戦略と 進捗状況

# 長期連結業績（売上高・営業利益）推移

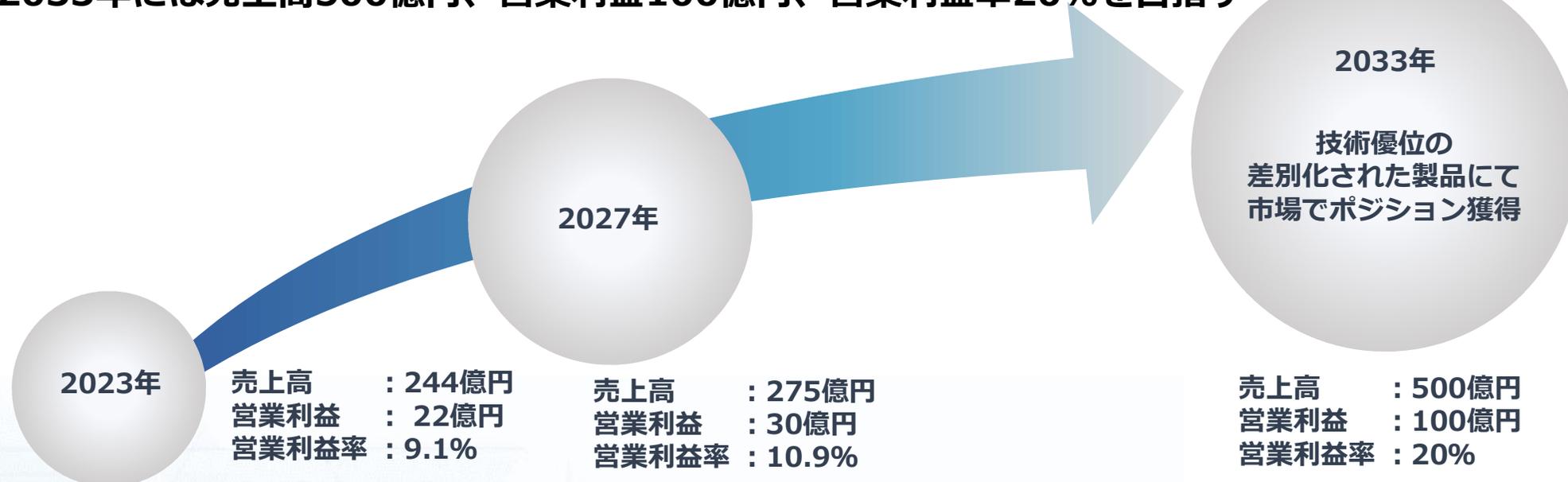
シリコンサイクルの影響を受けながら、これまでも半導体需要の増加に伴い成長  
2024年、2025年は我慢の年度になるも中長期的な成長を期す



\* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

# 中長期 数値目標と4つの軸での戦略

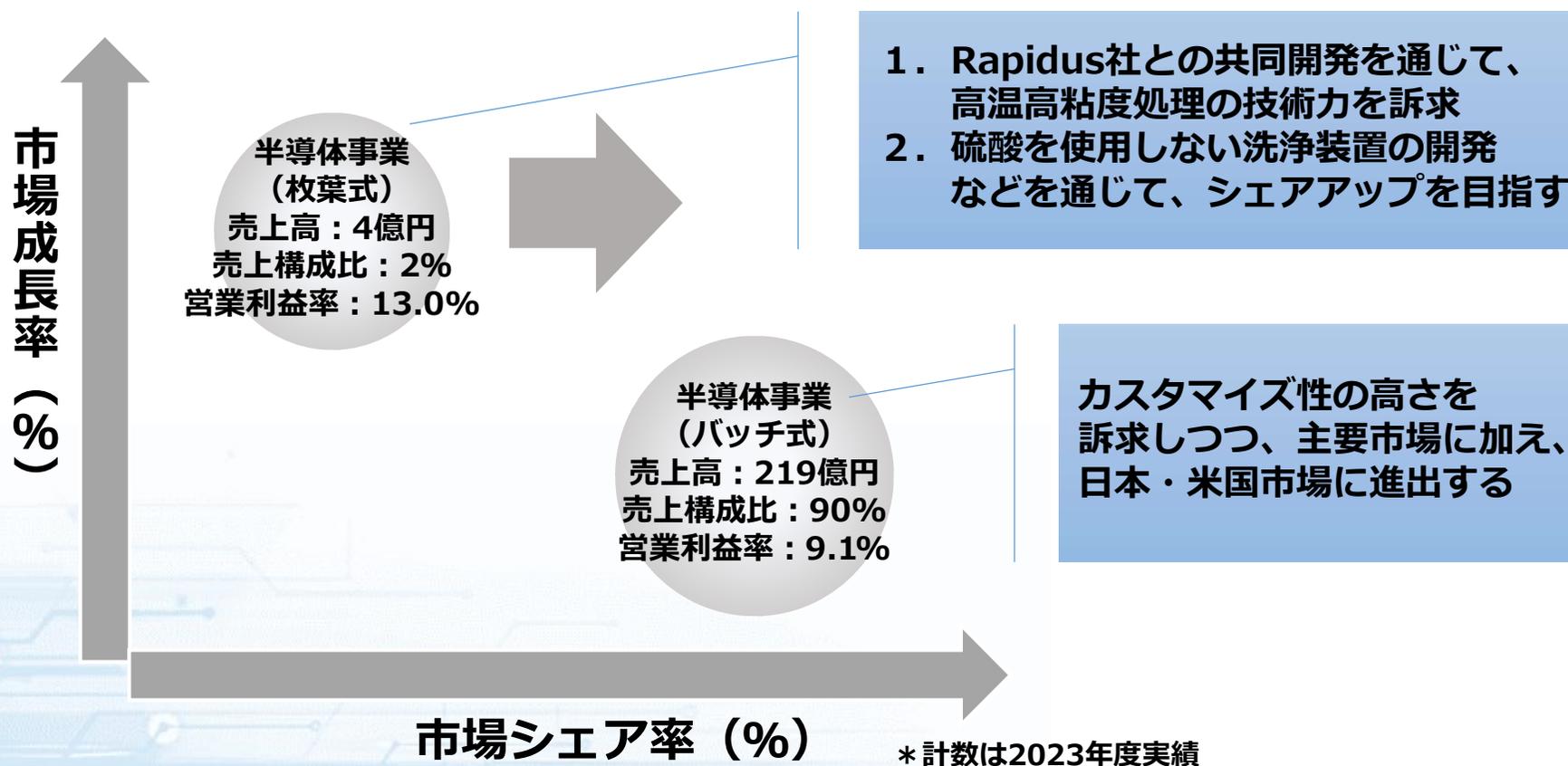
市場環境を考慮し、2027年売上高275億円、営業利益30億円、営業利益率10.9%を目指す  
2033年には売上高500億円、営業利益100億円、営業利益率20%を目指す



製品戦略	エリア戦略	組織戦略	製造戦略
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ バッチ式洗浄装置 処理槽の構成や設置数のカスタマイズ性の高さを訴求</li> <li>・ 枚葉式洗浄装置 高温高粘度薬液への対応を推進し差別化を図る</li> <li>・ GXへの対応 硫酸を使用しない洗浄装置の開発等GXへの対応を行う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主要市場(韓国、中国、台湾) 既存のリレーションを通じ取引濃化を進める</li> <li>・ 米国市場 : 現地法人を開設、“レガシー半導体領域”での顧客開拓に注力</li> <li>・ 日本市場 : 日本の優位性が高い車載用半導体や、国内回帰を進めるメーカーの開拓強化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ システムデザイン部の新設 当社の強みは、カスタマイズ性の高さと高温高粘度処理の技術。房野CEOの指導の下、一流の技術営業部隊を育成し、質の高い提案型営業を実現する</li> <li>・ 営業強化 : 米国へは初めて、日本へは15年ぶりに進出。商文化の違いを踏まえ顧客開拓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ サプライチェーン強化 景気変動の影響を強く受ける半導体業界において、生産能力の弾力化は必須。協力会社との関係を強化し、ファブレス化を推進する</li> <li>・ 新工場建設 : 生産能力の拡大や生産効率化、R&amp;Dの強化を企図し新工場を建設する</li> </ul>

# 戦略 成長への事業ポートフォリオ整理

バッチ式のシェアを守りつつ、差別化された枚葉式洗浄装置で成長を期す



- バッチ式洗浄装置は、今後も一定の市場規模を維持しつつ、半導体市場の成長に伴い緩やかに市場成長する見通し  
当社は世界シェア11%を占めており、今後も市場シェア率の拡大を目指す
- 枚葉式洗浄装置は、今後も主要な洗浄装置である可能性が高く、半導体の市場の成長に伴い大きく市場成長する見通し  
当社は高温高粘度処理に対応した枚葉式洗浄装置の開発・販売を通じて、市場シェアの拡大を目指す

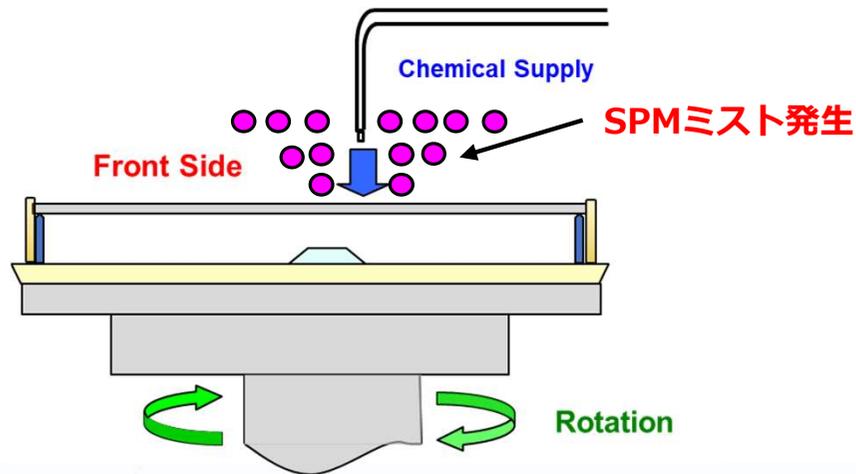
当社の技術優位性を生かした枚葉式洗浄装置を開発へ

## 新HTS

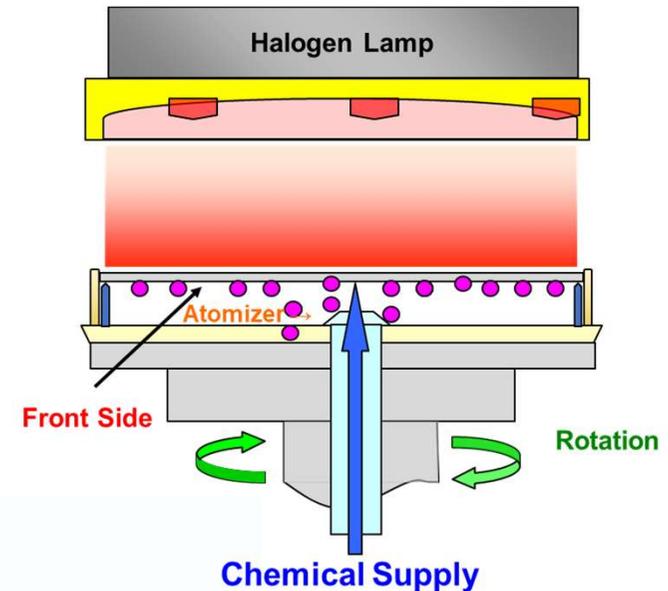
1. 硫酸以外のプロセス対応
2. 薬液（プロセス）別製品型式対応
3. リン酸は日本での実績を → 横展開
4. 03は台湾での実績を → 横展開



## A/B社 枚葉式SPM装置



## 当社 枚葉式SPM装置 (HTS-300)



### 【他社仕様】

- ・ケミカルの反応熱を利用(150~200℃)  
→ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- ・プロセス時間 : 5min/Wafer  
→必要ケミカル量 : 3000ml/Wafer  
(5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為)
- ・SPMミストによりパーティクル発生量が多い

### 【JET仕様】

- ・ハロゲンランプにて昇温(200~240℃)  
→**高温維持が容易**
- ・プロセス時間 : **0.5min**/Wafer  
→必要ケミカル量 : **150ml**/Wafer  
(他社の**約20分の1**の使用量)
- ・処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用することでSPMミストが拡散せず、**パーティクルの発生量を抑制**

# 当社 枚葉式装置のプロセス種類

薬液種類	JET装置	イメージ	機能と性能
<b>SPM(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</b> 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	<b>HTS</b> HTS-300		<b>薬液使用量の削減</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロセス時間の大幅短縮により薬液使用量は他社の20分の1にまで削減</li> <li>・ヒータによる温度制御によって高いレジスト除去性能を実現 効率的な処理が可能に</li> <li>・除去したレジストは重力で落下するため、パーティクル軽減</li> </ul>
<b>O<sub>3</sub> GAS</b> 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	<b>EcO<sub>3</sub></b> OMR-3000		<b>環境への負荷が少なく、ランニングコストも低い</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・枚様式SPM装置の構造を生かし、O<sub>3</sub> GASでの処理を実現</li> <li>・O<sub>3</sub> GASを使用することで環境負荷を軽減しながらSPM同様のプロセスが可能</li> <li>・酸とアルカリによる反応生成物が形成されないため、1つの処理モジュールでSC1処理可能</li> </ul>
<b>HP(H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>)</b> Front side SiN除去	<b>Rush</b> HPR-3000		<b>枚葉装置初の高温高エッチングレート処理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・JETの特許技術を活用し、最先端の窒化膜処理を枚葉式装置で実現</li> <li>・高いウェハ均一性を実現</li> <li>・高温維持により、高いエッチングレートを実現</li> </ul>
<b>HP(H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>)</b> Back side SiN除去	<b>Rush</b> HBE-3000		

特許：第5079145号 第5165131号

# Rapidus社からの開発業務

- Rapidus社はIBM社と戦略的パートナーシップを締結し、2nm半導体の開発・生産を目指す
- Rapidus社は多品種少量生産で「どこよりも速い」半導体製造の実現を目指し、全枚葉式を軸としている
- 製造装置は基本的にIBM社ラインの装置が導入されるが、リン酸エッチング処理についてはIBM社ラインに枚葉式がなく、別途開発が必要となっている（当社が開発中）
- 現状、研究開発段階（α機）を終え、試作装置製作に関する研究開発（β機）段階、2025年には試作機を納入
- 当社は2027年量産ラインへの当社装置納入を目指す



Rapidus千歳工場 (IIM)  
2023年9月起工  
2025年試作ライン立ち上げ、  
2027年量産ライン立ち上げ予定



HTS-300

# BW3500①

主力機種BW3000が開発から20年を経過、より顧客ニーズに応えられる後継機種として、BW3500を開発

- 今後投資の中心になる**28nm以上のプロセスをターゲットに**
- RCA洗浄の他社製品からの切替を意識

## BW3000からの改善点

1. フットプリントの削減  
(装置面積にて15~16%、装置全長で20%の削減)
2. 新たな搬送方式の採用  
(搬送アームに加え、Moving / Single Liferによる搬送)
3. 環境・安全対策  
(OHT専用PORTの設置、薬液霧困気漏れ軽減の機密性向上)
4. 破損防止対策 (樹脂槽の採用)
5. 操作性向上 (操作画面の大型化、カラー化、情報量アップ)

ほか、ONE BATH、メタルイオン対策、新排気システム、薬液使用量削減、スループット向上、新乾燥システムの採用などを実現



BW3500

## 高精度プロセスへの対応が特徴

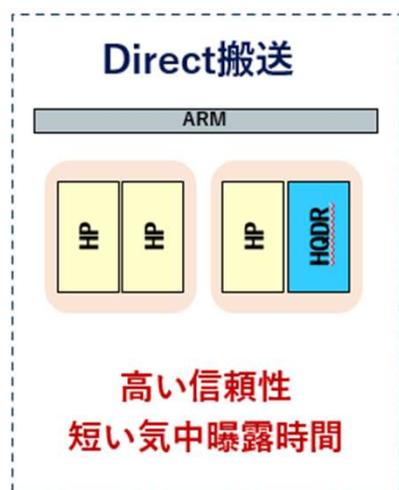
### BW3000との比較 -Comparison with BW3000-



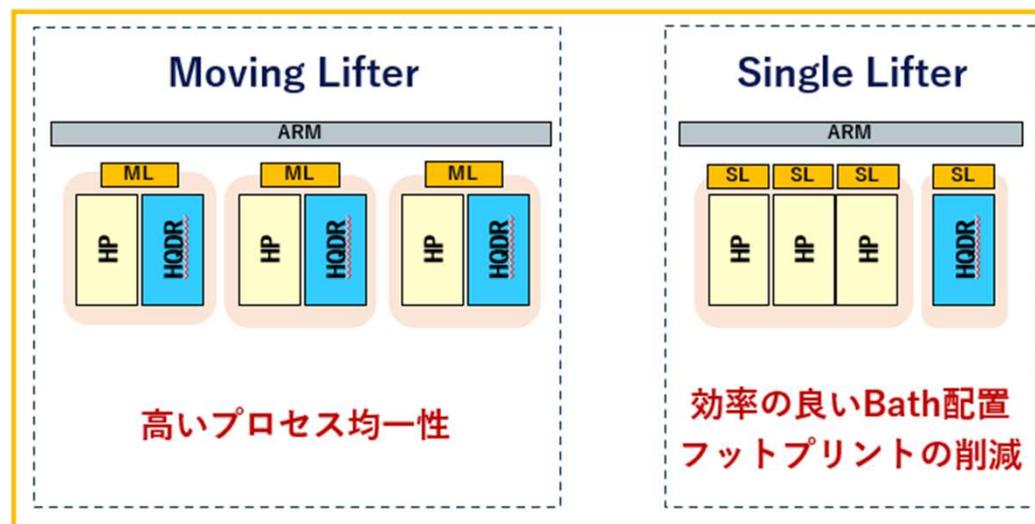
#### ■ 新モジュール構成追加による高精度プロセスへの対応

JET標準の薬液槽連続配置に加え、プロセスクリティカルな工程に対してはChemical+DIWを基本モジュールとしたBath間差の無い構造を選択することが可能

BW3000



BW3500 (組み合わせ可能)



# BW3500③ 中国、韓国で引き合い対応中

## 中国、韓国で引き合い対応中

### 中国

1. SMICグループとの関係維持
2. 既存顧客（ファウンドリ、メモリー）の増産への対応
3. **BW3500による他社装置からの切替促進**

### 韓国

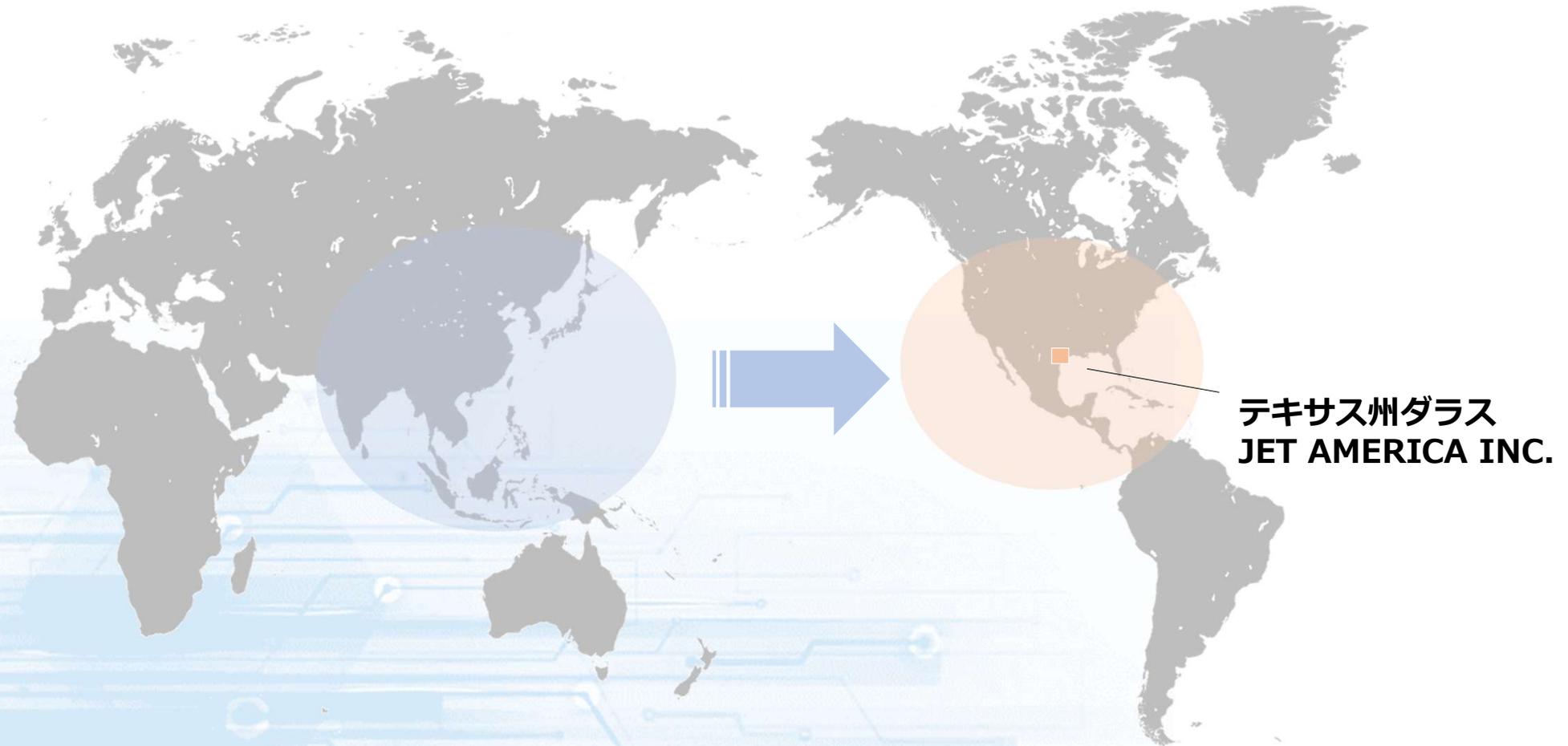
1. **BW3500のサムスンでの拡販**
2. SiC装置対応強化  
（他エリアへの横展開）
3. 新HTSでの拡販

### 台湾

1. TSMC向けHTS/Rushの対応を優先  
（他エリアへの横展開）
2. 既存顧客との関係維持
3. **BW3500による他社装置からの切替促進**

# エリア戦略 北米での市場開拓

地政学的な環境変化に対応するため、北米に子会社JET AMERICA INC. 設立  
北米展開の拠点に



# 米国子会社 インターポーザ洗浄装置受注

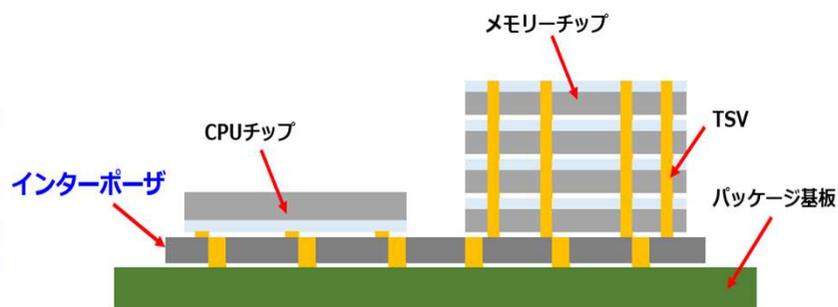
テキサス・インスツルメンツ（TI）などが本社を置く  
 テキサス州に米国子会社JET AMERICA INC.を2024年1月設立  
 レガシー領域顧客の開拓を始める一方、  
 半導体チップと基板を電氣的に接続する「インターポーザ」向け  
 洗浄装置を受注、出荷、2025年には現地納品、立上を予定

## インターポーザ (配線回路基板)

「間に挟む」を意味するラテン語が  
 起源

半導体チップをレゴブロックのよう  
 組み合わせる技術（チップレット）  
 において、中継部材として極めて需  
 要な役割を果たす部材

AI半導体の先進パッケージ  
 の基本構造になる2.5Dや3Dパッ  
 ケージに欠かせない



JET AMERICA INC.

### 3. サステナビリティ経営に向けて

# サステナビリティ経営メッセージ

上場企業として、サステナビリティ経営についてはしっかりした取り組みが必要  
業績的に踊り場のこの時期に企業としての体制を強固なものにする意味も含め  
2024年12月13日 サステナビリティ経営方針を公表

半導体洗浄装置において、環境負荷の低いプロセスにて代替える  
洗浄装置の開発により、社会に貢献すべく尽力しております。

またここ数年の売上増大に対応すべく新工場を建設予定であり、最先端技術の導入による生産性の向上、研究開発の加速を図るとともに、社会的価値への貢献として環境にやさしい地域社会との共生を実現できる工場にしたいと考えております。

企業は人なりの考えのもと、2017年以降、毎年5~7名の新卒社員を採用してきており、加えて新たな中堅社員の採用にも積極的に取り組んできました。新たな人財教育システムを含む人事制度を導入し、人財の早期戦力化を目指していきます。

# サステナビリティ経営方針



# マテリアリティ（重要課題）と取組方針

マテリアリティ(重要課題)	取組方針
1. 気候変動対策	事業活動における環境負荷の低減と気候変動対策を実践する
2. 環境負荷低減	環境負荷の高い硫酸を使用しない洗浄方法を確立する
3. 労働安全衛生・健康経営	労働安全衛生の法令順守のもと、従業員が安全、健康、快適に働くことができる職場を提供する
4. 人財価値の最大化	価値創造の源泉である人財が多彩な能力を最大限に発揮できるよう、人財育成投資を積極的に行う
5. Well-being・DE&I 注1)	多様な人財が働きやすく、働きがいを持って活躍できる職場環境を構築する
6. 先端半導体国産化への貢献	革新的枚葉式洗浄装置の技術開発を継続し、量産化を推進する
7. サプライチェーンマネジメント	サプライチェーン全体でのサステナビリティ推進により、価値創造を図る

注1) Well-beingとは、 ➡ 「身体的、精神的、社会的に満たされている状態」  
 DE&I（ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン）とは ➡ 「多様性」を「受容・包括」し、  
 それぞれに「公平」な機会提供のもとで、互いに尊重しながら成長できる環境づくりを目指した考え方

A blue rectangular box containing the word 'Appendix' in white, bold, sans-serif font.

# Appendix

リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身  
**同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、**  
販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD. (以下、「ZEUS」)の全額出資のもと、  
2009.4.24に設立、2009.5に**エス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生**

### ■会社概要

会社名 株式会社ジェイ・イー・ティ

英訳名 J.E.T. Co., LTD.

設立 2009年4月

資本金 1,848百万円 (2024年12月31日時点)

所在地 岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番

T E L 0865-69-4080

代表者 代表取締役 CEO 房野 正幸

従業員数 169名  
293名 ※連結会社含む全従業員数  
(2024年12月31日時点)

事業内容 半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービス等

主要納入先 サムスン電子 (韓国) SMIC (中国)

# グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



**所在地:** 大韓民国  
京畿道華城市

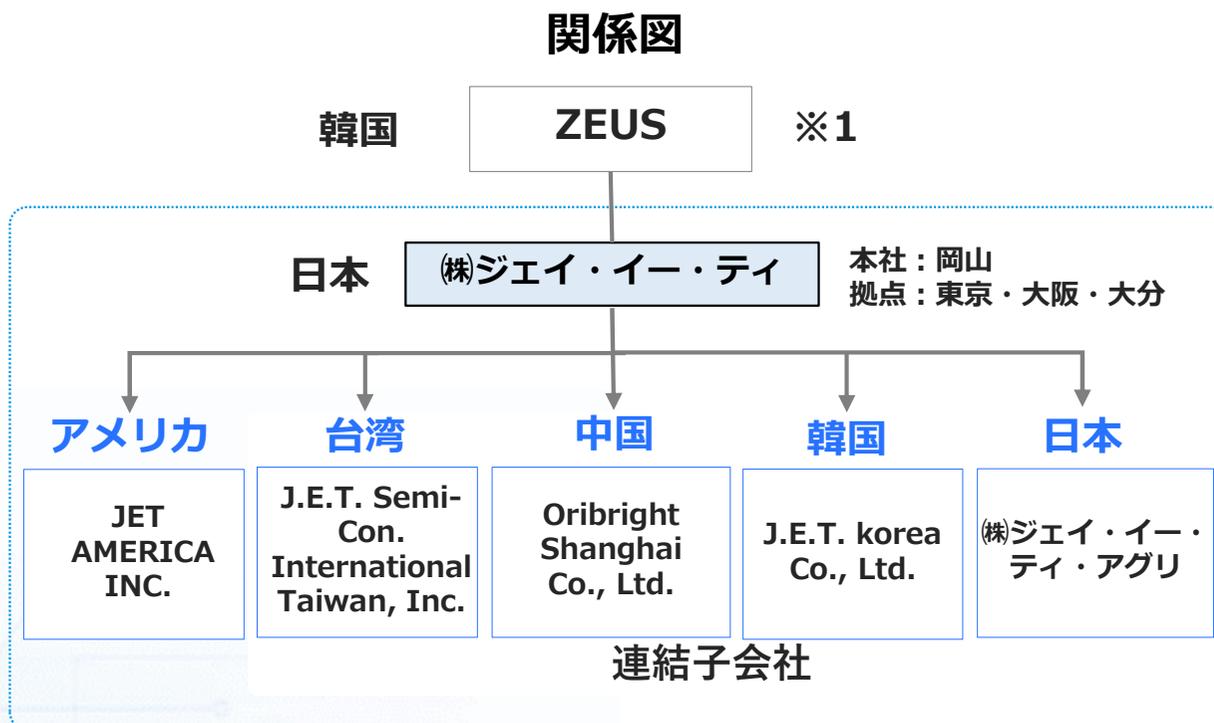
**資本金:** 15,530,995千KRW

**事業の内容:** 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

**当社の議決権の保有割合(%):** 66.3% (直接)

**関連当事者との関係:** 営業取引

**取引の内容:** 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

\* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

- 国内拠点
- 海外拠点



## 韓国拠点 23名

J.E.T. Korea Co., Ltd.

- Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



## 中国拠点 73名

\* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.  
(HEAD Office) 台湾本社



## 台湾拠点 21名

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.  
(Singapore branch) シンガポール支社

## シンガポール 3名

九州出張所(※1)

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※3)

本社 (岡山)



- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供。
- ※2 大阪事務所は、LIB製品の営業を担当。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培。



JET AMERICA INC.

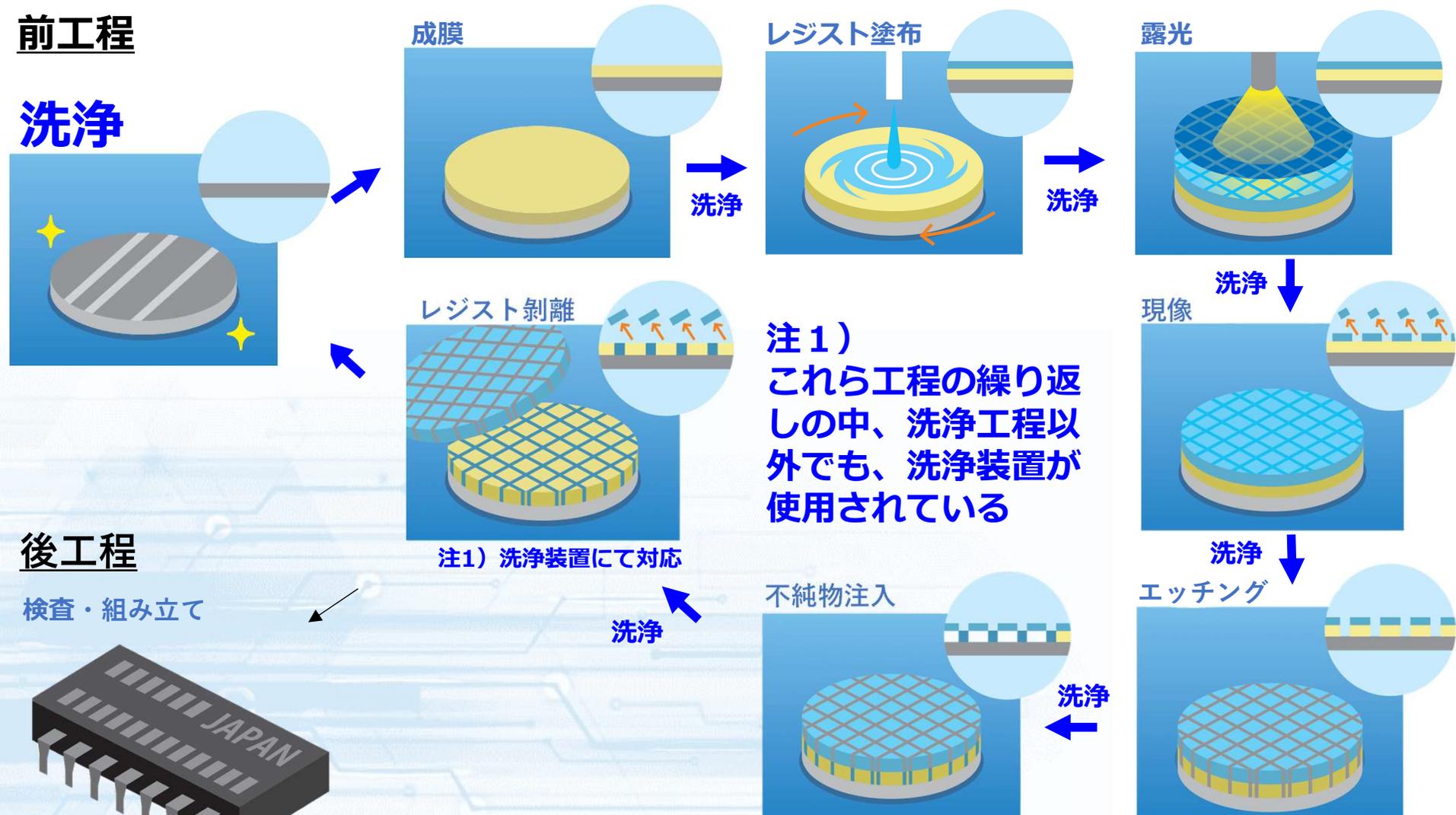
## 米国拠点 3名

# 半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程  
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

## 前工程

### 洗浄

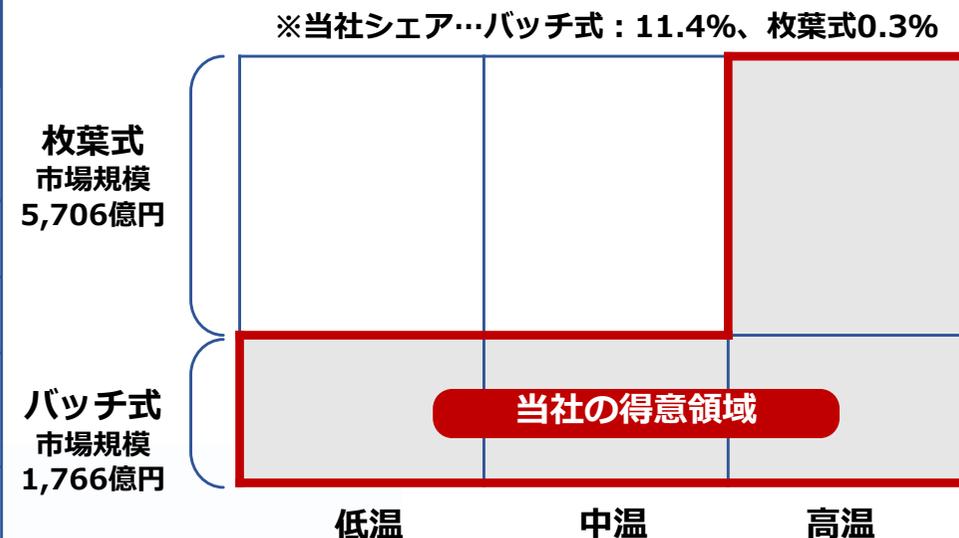


## 後工程

検査・組み立て

# 半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社の得意領域

		バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要		25~50枚のウエハを一括洗浄	ウエハを1枚ずつ洗浄
長所		生産性が高い	精密な洗浄が可能
短所		ウエハの塵を拾い易い	生産性が低い
現状		生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主流洗浄装置
高温高粘度処理	特徴	プロセス温度維持が容易	プロセス温度維持が難しい
	硫酸	○ (主流)	△ (一部対応)
	リン酸	○ (主流)	× (対応なし)
市場規模 (2023/世界)		1,525億円 (当社シェア 14.3%)	5,986億円 (当社シェア 0.1%)



# 競合状況と差別化要素

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

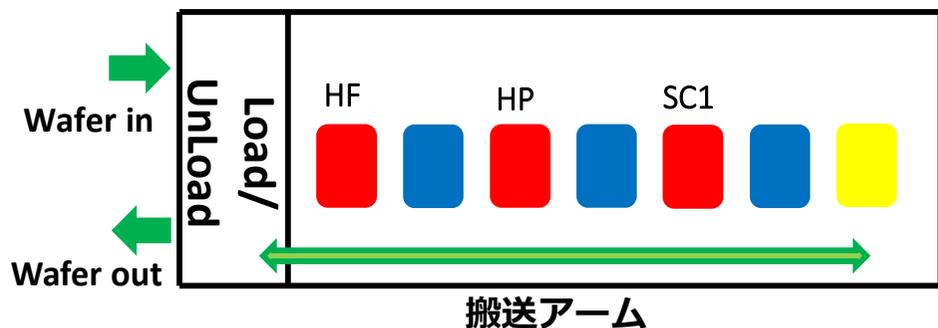
		当社	A社	B社
会社規模 (直近期売上高/営業利益)		244億円 (22億円)	4,608億円 (765億円)	2兆2,090億円 (6,177億円)
シェア (2022年度の 市場規模)	バッチ式 (1,766億円)	11.4% (202億円)	47.8% (835億円)	28.8% (508億円)
	枚葉式 (5,706億円)	0.3% (11億円)	48.5% (2,170億円)	28.3% (1,523億円)
技術	RCA洗浄	△	◎	○
	硫酸洗浄	◎	○	△
	リン酸洗浄	◎	○	△
	その他	○	△	○
生産能力		△ (量産能力は低い)	◎ (量産能力あり)	◎ (量産能力あり)
カスタマイズ性		◎ (カスタマイズ性に強み)	△ (標準化装置に強み)	△ (標準化装置に強み)

(出所) 経済産業省「令和5年6月 半導体・デジタル産業戦略」より、評価は当社独自の認識

- 当社の競合他社は、売上規模が数千億円～数兆円の大企業で、高品質で標準化した装置を量産できる点が強み
- 当社は量産能力に劣るものの、難易度の高い高温高粘度処理やカスタマイズ性の高さに強みがある  
大企業が参入しづらいニッチ領域へ、小回りの利く当社が参入し、シェアを獲得している状況

# JETバッチ装置の優位性 → 唯一F-Typeを持つ

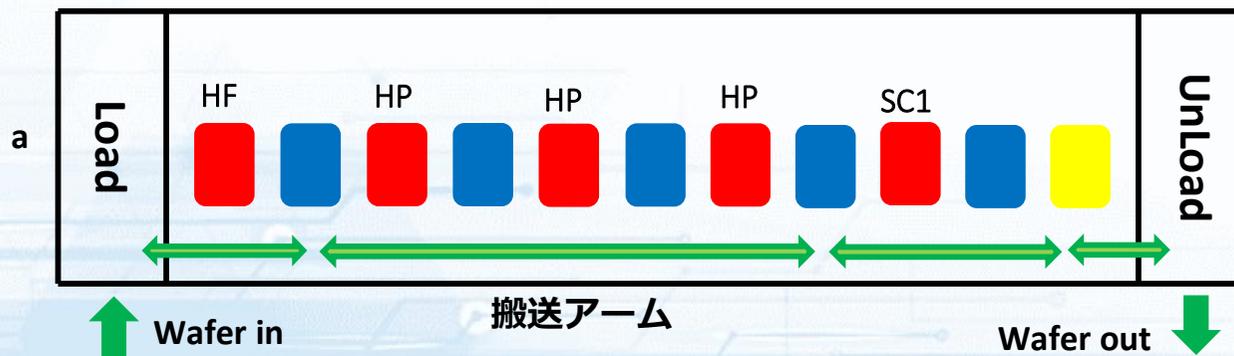
## I-Type A社 / B社 / 当社



### 特徴

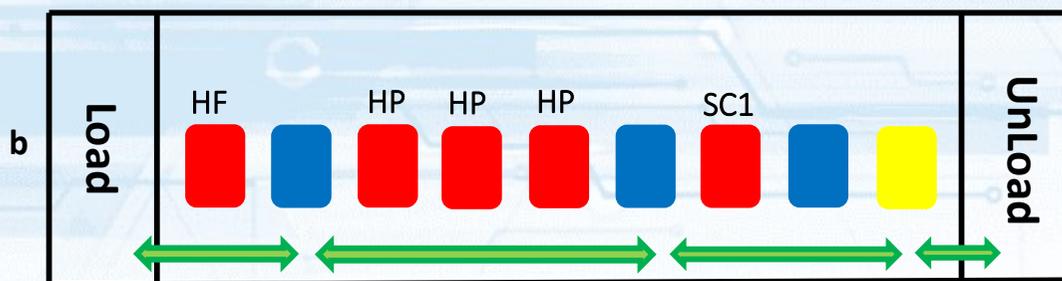
- コンパクト
- 処理槽 MAX 8 槽  
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- スループット 最大250w/h

## F-Type 当社のみ



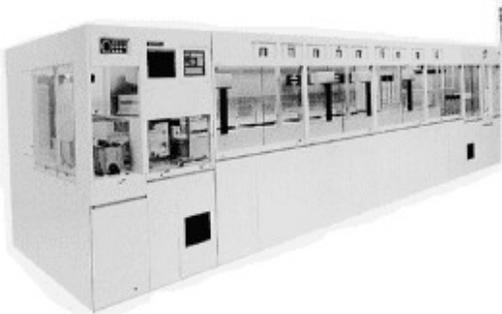
### 特徴

- 少し大きい
- 処理槽 MAX14槽  
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- a/b 選択可能
- bはケミカル槽を連続配置可能
- 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- **スループット 最大 500w/h**



\* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能）</li> <li>◎生産効率の向上</li> <li>◎500WPHに対応する高速LD/ULD</li> <li>◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能</li> <li>◎二酸化炭素の低減</li> <li>◎気体流量のコントロールを実現</li> <li>◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮</li> <li>◎SEMI standardに対応</li> <li>◎EES（EDA or TDI）に対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能</li> <li>◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化</li> <li>◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現</li> <li>◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少</li> <li>◎気泡発生の高減化を実現</li> <li>◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上</li> <li>◎濃度の安定性を向上</li> <li>◎豊富な処理槽種類に対応</li> <li>◎1薬液プラス1DIW構成に対応</li> </ul>
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 高い生産効率</li> <li>◎ 高い洗浄能力</li> <li>◎ 省フットプリント</li> <li>◎ 顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 最小150ccの薬液消費量での処理を実現</li> <li>◎ 最高240℃での高温処理を実現</li> <li>◎ 最短30秒でのストリップ処理を実現</li> <li>◎ ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現</li> </ul>
価格帯 (平均単価) (百万円)	150～210	330～540

# 注意事項

## 本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2025年2月7日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しの変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

## 本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ  
経営戦略部

TEL 0865-69-4281